

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日
ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

ご注意書き

1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りが無いことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。
標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当）
特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム等
8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご照会ください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレクトロニクス株式会社とその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

H8/300H Tiny シリーズ

二次元配列

要旨

指定されたデータを，二次元配列から検索し，データが一致したときのアドレス，配列の要素 (x,y) を設定します。

動作確認デバイス

H8/300H Tiny シリーズ

目次

1. 機能	2
2. 引数	2
3. 内部レジスタ変化およびフラグ変化.....	2
4. プログラミング仕様.....	3
5. 注意事項.....	3
6. 説明	4
7. フローチャート	6
8. プログラムリスト.....	7

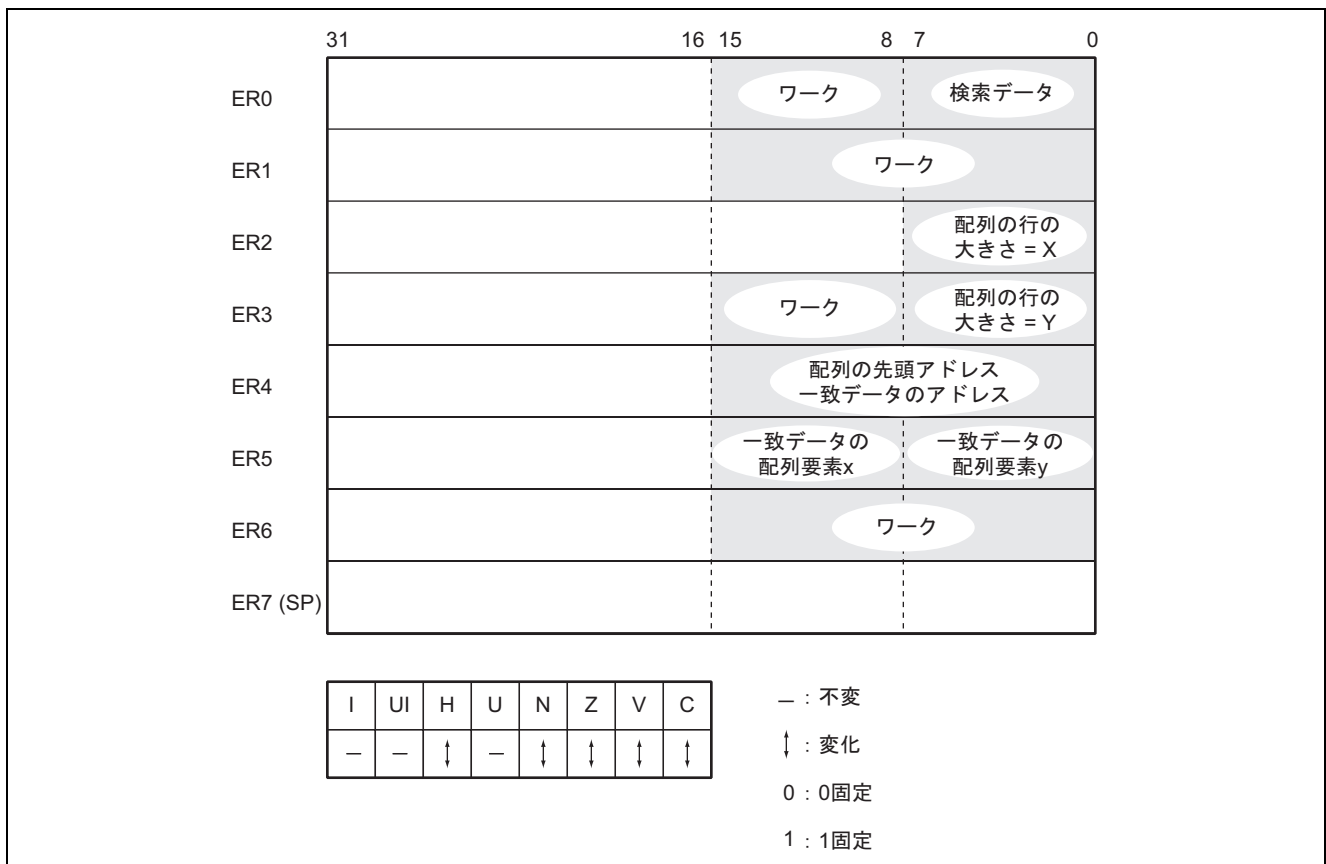
1. 機能

- (1) 指定されたデータを，二次元配列（以下，配列と略します）から検索し，データが一致したときのアドレス，配列の要素（x,y）を設定します。
- (2) 対象となるデータは，1 バイトの符号無し整数です。
- (3) 配列の要素は，1 バイトの符号無し整数です。
- (4) 配列の大きさは，255 バイト × 255 バイトまでの範囲で設定されます。

2. 引数

内容		格納場所	データ長
入力	検索データ	R0L	1
	配列の先頭アドレス	R4	2
	配列の行の大きさ = X	R2L	1
	配列の行の大きさ = Y	R3L	1
出力	一致データのアドレス	R4	2
	一致データの配列要素 x	R5H	1
	一致データの配列要素 y	R5L	1
	一致データの有無	C フラグ (CCR)	-

3. 内部レジスタ変化およびフラグ変化



4. プログラミング仕様

プログラムメモリ (バイト)	46
データメモリ (バイト)	0
スタック (バイト)	0
ステート数	1986
リエントラント	可
リロケーション	可
途中割り込み	可

5. 注意事項

プログラミング仕様のクロックサイクル数は、図 1 の例を実行した場合の値です。
配列の要素のどちらかが “0” であれば直ちに終了し、C フラグをクリアします。

6. 説明

6.1 機能説明

(1) 引数の詳細は以下のとおりです。

(a) 入力引数は、次のように設定します。

R0L : 検索するデータ

R4 : 配列の先頭アドレス

R2 : 配列の行の大きさ (x)

R3L : 配列の列の大きさ (y)

(b) 出力引数は、次のように設定します。

R4 : 一致データのアドレス

R5H : 一致データの配列要素 (x)

R5L : 一致データの配列要素 (y)

C フラグ (CCR) : ソフトウェア ARRAY 終了時の状態を示します。

C フラグ = 1 : 検索データと一致するデータが配列上にあったことを示します。

C フラグ = 0 : 検索データと一致するデータが配列上になかったことを示します。

(2) 図 1 にソフトウェア ARRAY の実行例を示します。

入力引数を のように設定すると、図 1 の配列 (16 × 16) を参照し、 のように一致データのアドレスが R4、配列要素 x が R5H、配列要素 y が R5L に設定されます。

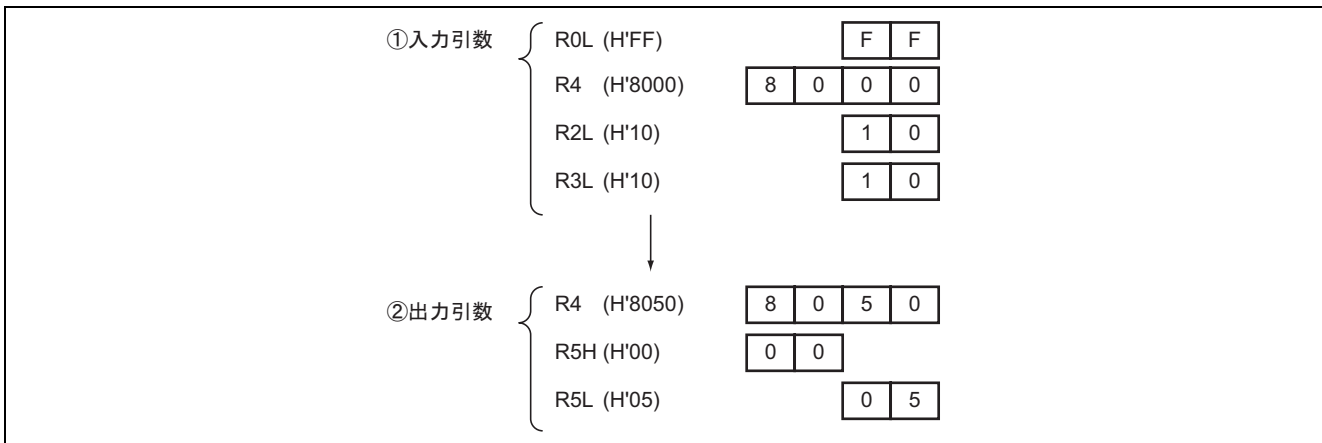


図 1 ソフトウェア ARRAY の実行例

(3) ソフトウェア ARRAY を実行する際、あらかじめ図 2 のような配列が必要となります。

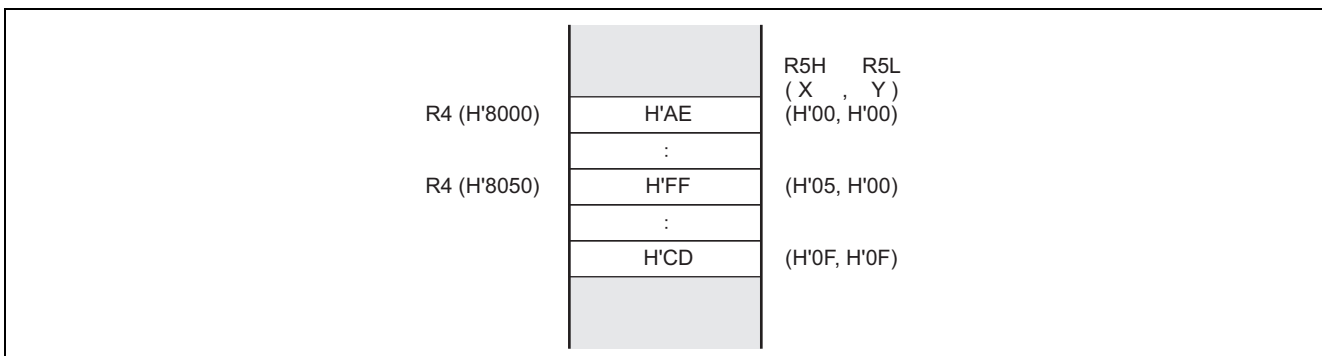


図 2 配列の空間

(4) 図 3 に配列の詳細について説明します。

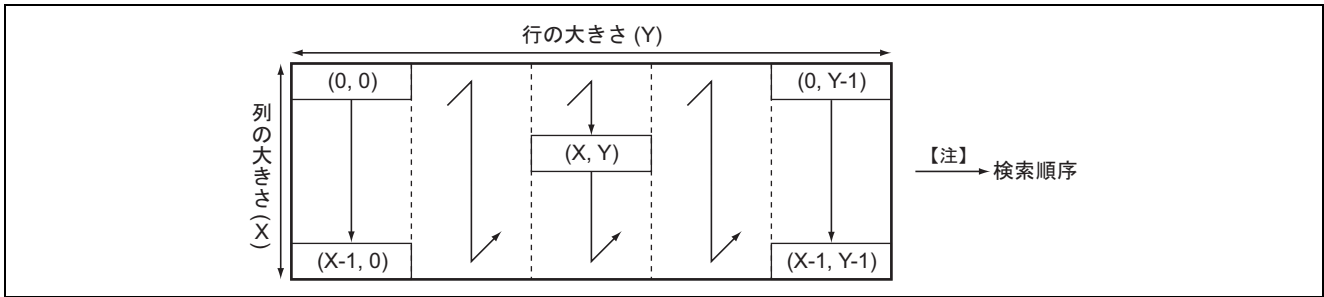


図 3 二次元配列

- (a) 行数 (X) と列数 (Y) で配列の大きさを表わします。
- (b) 配列の要素は (x,y) (行の要素, 列の要素) で表し, $(0,0)$ から $(X-1, Y-1)$ の範囲内で表わされます。
- (c) $(0,0)$ を配列の要素の先頭アドレスとし, 図 3 のような順序で検索を行ないます。

6.2 使用上の注意

配列の大きさ X と列の大きさ Y には, “0” を設定しないでください。

“0” を設定するとデータを検索せず C フラグ (CCR) をクリアし, 終了します。

6.3 データメモリの説明

ソフトウェア ARRAY では, データメモリを使用していません。

6.4 使用例

検索データと配列の先頭アドレス, 行の大きさ, 列の大きさを設定し, ソフトウェア ARRAY をサブルーチンコールします。

```

I-WORK1 .RES.W 1      配列の先頭アドレスを格納するデータメモリエリア
I-WORK2 .RES.B 1      配列の大きさ (x) を格納するデータメモリエリア
I-WORK3 .RES.B 1      配列の大きさ (y) を格納するデータメモリエリア
I-WORK4 .RES.B 1      検索データを格納するデータメモリエリア
.
.
.
O-WORK1 .RES.W 1      一致したデータアドレスを格納するデータメモリエリア
O-WORK2 .RES.B 1      一致した配列要素 (x) を格納するデータメモリエリア
O-WORK3 .RES.B 1      一致した配列要素 (y) を格納するデータメモリエリア
.
.
.
MOV.B @I-WORK4,R0L ..... 検索データを設定
MOV.W @I-WORK1,R4 ..... 配列の先頭アドレスを設定
MOV.B @I-WORK2,R2H ..... 配列の大きさ (x) を設定
MOV.B @I-WORK3,R2L ..... 配列の大きさ (y) を設定

JSR @ARRAY ..... ソフトウェアARRAYをサブルーチンコール

MOV.W R4,@O-WORK1 ..... 一致したデータアドレスを格納
MOV.B R2H,@O-WORK2 ..... 一致した配列要素 (x) を格納
MOV.B R2L,@O-WORK3 ..... 一致した配列要素 (y) を格納
.
.
.
    
```


8. プログラムリスト

```

1          1          ;*****
2          2          ;*
3          3          ;*      NAME:  2-DIMENSIONAL ARRAY (ARRAY)      *
4          4          ;*
5          5          ;*****
6          6          ;*
7          7          ;*      ENTRY:  R0L      (REFERENCE DATA)      *
8          8          ;*      R2L      (NUMBER OF COLUMNS [X])      *
9          9          ;*      R3L      (NUMBER OF ROWS [Y])      *
10         10         ;*      R4      (ARRAY START ADDR)      *
11         11         ;*
12         12         ;*      RETURNS: R5H      (ARRAY ELEMENT: COLUMN INDEX [x])  *
13         13         ;*      R5L      (ARRAY ELEMENT: ROW INDEX [y])      *
14         14         ;*      R4      (MATCHING DATA ADDR.)      *
15         15         ;*      C flag OF CCR (C=1:TRUE , C=0:FALSE)      *
16         16         ;*
17         17         ;*****
18         18         ;
19         19         .CPU      300HN
20 0000     20         .SECTION ARRAY_code,CODE,ALIGN=2
21         21         .EXPORT  ARRAY
22         22         ;
23         23         ARRAY  .EQU  $          ;Entry point
24 0000 0D41  24         MOV.W  R4,R1
25 0002 79060000 25         MOV.W  #H'0000,R6      ;Clear R6
26 0006 1CAE    26         CMP.B  R2L,R6L
27 0008 4720    27         BEQ   EXIT1      ;Branch to exit if Z=1
28 000A 1CBE    28         CMP.B  R3L,R6L
29 000C 471C    29         BEQ   EXIT1      ;Branch to exit if Z=1
30 000E 50A3    30         MULXU R2L,R3      ;Get total no. of array elements (R3)
31 0010     31         LBL1
32 0010 6840    32         MOV.B  @R4,R0H      ;Load array data
33 0012 1C80    33         CMP.B  R0L,R0H
34 0014 470A    34         BEQ   LBL2      ;Branch if data found
35 0016 1B03    35         SUBS  #1,ER3      ;Decrement R3
36 0018 1D36    36         CMP.W  R3,R6
37 001A 4710    37         BEQ   EXIT2      ;Branch if false
38 001C 0B04    38         ADDS  #1,ER4      ;Increment data pointer
39 001E 40F0    39         BRA   LBL1      ;Branch always
40 0020     40         LBL2
41 0020 0D45    41         MOV.W  R4,R5
42 0022 1915    42         SUB.W  R1,R5      ;Found data: distance from 1st addr.
43 0024 51A5    43         DIVXU R2L,R5      ;Get array index [x,y]
44 0026 0401    44         ORC.B #H'01,CCR      ;Set C flag of CCR
45 0028 4002    45         BRA   EXIT2      ;Branch always
46         46         ;
47 002A     47         EXIT1
48 002A 06FE    48         ANDC.B #H'FE,CCR      ;Clear C flag of CCR
49 002C     49         EXIT2
50 002C 5470    50         RTS
51         51         ;
52         52         .END
*****TOTAL ERRORS      0
*****TOTAL WARNINGS    0

```

改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
2.00	2006.02.28	-	日立版からルネサス版へフォーマット変更

安全設計に関するお願い

1. 弊社は品質、信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品は故障が発生したり、誤動作する場合があります。弊社の半導体製品の故障又は誤動作によって結果として、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないような安全性を考慮した冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計などの安全設計に十分ご留意ください。

本資料ご利用に際しての留意事項

1. 本資料は、お客様が用途に応じた適切なルネサス テクノロジ製品をご購入いただくための参考資料であり、本資料中に記載の技術情報についてルネサス テクノロジが所有する知的財産権その他の権利の実施、使用を許諾するものではありません。
2. 本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例の使用に起因する損害、第三者所有の権利に対する侵害に関し、ルネサス テクノロジは責任を負いません。
3. 本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他全ての情報は本資料発行時点のものであり、ルネサス テクノロジは、予告なしに、本資料に記載した製品または仕様を変更することがあります。ルネサス テクノロジ半導体製品のご購入に当たりましては、事前にルネサス テクノロジ、ルネサス販売または特約店へ最新の情報をご確認頂きますとともに、ルネサス テクノロジホームページ(<http://www.renesas.com>)などを通じて公開される情報に常にご注意ください。
4. 本資料に記載した情報は、正確を期すため、慎重に制作したものです。万一本資料の記述誤りに起因する損害がお客様に生じた場合には、ルネサス テクノロジはその責任を負いません。
5. 本資料に記載の製品データ、図、表に示す技術的な内容、プログラム及びアルゴリズムを流用する場合は、技術内容、プログラム、アルゴリズム単位で評価するだけでなく、システム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。ルネサス テクノロジは、適用可否に対する責任を負いません。
6. 本資料に記載された製品は、人命にかかわるような状況の下で使用される機器あるいはシステムに用いられることを目的として設計、製造されたものではありません。本資料に記載の製品を運輸、移動体用、医療用、航空宇宙用、原子力制御用、海底中継用機器あるいはシステムなど、特殊用途へのご利用をご検討の際には、ルネサス テクノロジ、ルネサス販売または特約店へご照会ください。
7. 本資料の転載、複製については、文書によるルネサス テクノロジの事前の承諾が必要です。
8. 本資料に関し詳細についてのお問い合わせ、その他お気づきの点がございましたらルネサス テクノロジ、ルネサス販売または特約店までご照会ください。